熔融 6061 和 4043 铝合金在 纯钛表面的反应润湿

Reactive Wetting of Pure Titanium by Molten 6061 and 4043 Aluminum Alloys

> 钟伟强,靳 鹏,李富祥,林巧力,陈剑虹
> (兰州理工大学 省部共建有色金属先进加工与再利用 国家重点实验室,兰州 730050)
> ZHONG Wei-qiang, JIN Peng, LI Fu-xiang, LIN Qiao-li, CHEN Jian-hong
> (State Key Laboratory of Advanced Processing and Recycling of Non-ferrous Metal, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

摘要:利用改良座滴法研究了高真空条件下熔融 6061 和 4043 铝合金在 600,650,700℃分别与纯钛(TA2)的反应润湿 行为。结果表明:Al/Ti 体系属于典型的反应润湿,铝合金中微量的 Si 元素在界面上产生了明显富集且满足热力学条 件;界面上形成了富 Si 的致密的层片状 Ti₇Al₅Si₁₂相,致密层产生后阻碍熔体润湿母材;Ti₇Al₅Si₁₂相的分解及三相线附 近疏松的粒状 Al₃Ti 相产生后能够破除钛表面的氧化膜,进而促进润湿;6061/TA2 和 4043/TA2 两润湿体系铺展动力 学均可由反应产物控制(Reaction Product Model)模型描述,整个润湿铺展过程分为两个阶段,即先呈指数铺展、后呈线 性铺展;6061 铝合金对应两个阶段的铺展活化能分别为 56kJ/mol 和 112kJ/mol,4043 铝合金以指数铺展为主,铺展活化 能为 47kJ/mol,Ti₇Al₅Si₁₂相的分解对应于指数铺展阶段。

关键词:反应润湿;热浸镀;前驱膜;TA2

doi: 10.11868/j.issn.1001-4381.2017.000684

中图分类号: TG174.443 文献标识码: A 文章编号: 1001-4381(2017)12-0017-08

Abstract: The wetting of TA2 pure Ti by two industrial grade Al alloys (*i. e.*, 6061 Al and 4043 Al alloys) was studied by using the modified sessile drop method at 600,650,700°C under high vacuum. The results show Al/Ti system is a typical reactive wetting, the small amount of alloying element Si in the Al alloys can cause significant enrichment at liquid/solid interface and satisfy thermodynamic condition; the formation of the Si-rich phase (Ti₇Al₅Si₁₂) strangling material exchange at triple line zone; Ti₇Al₅Si₁₂ decomposition and Al₃Ti formation can remove the oxide film and promote wetting behavior can be divided into two stages: the first stage for the nonlinear spreading and the second stage for the linear spreading; the activation energies which are 56kJ/mol, 47kJ/mol for nonlinear stages of 6061 Al and 4043 Al alloys, and 112kJ/mol for linear stage of 6061 Al alloys, respectively, Ti₇Al₅Si₁₂ decomposition is corresponding to the nonlinear spreading.

Key words: reactive wetting; hot dip; precursor film; TA2

纯钛及其合金作为潜在的高温材料被广泛应用于 航空航天领域,其中钛合金高温抗氧化性及耐腐蚀性 能备受瞩目^[1]。然而,当纯钛及其合金的使用温度超 过 973K 时抗氧化性能急剧下降,从而限制了钛合金 在高温下的应用^[2]。目前,利用渗 Si 及渗 Al 工艺在 钛合金表面产生金属间化合物层,是改善钛合金抗氧 化性能及提高材料表面硬度的有效途径^[3,4]。究其原因在于,材料表面产生的 Al_{3} Ti 金属间化合物硬度较高,并且 Al_{3} Ti 是唯一能够在表面产生 $Al_{2}O_{3}$ 保护膜的Al-Ti 金属间化合物^[5]。热浸铝工艺作为廉价可靠的材料防护方法,在铝合金中添加Si元素同样可以在钛表面产生一层致密的金属间化合物镀层,同时能够

有效地替代渗 Si 及渗 Al 工艺。

然而,优质镀层的获得与铝合金在材料表面的润 湿性、铺展特性、界面反应等密切相关^[6]。理论上,熔 融铝合金在钛基板表面好的润湿性是获得优质镀层的 关键因素。铝合金中添加微量的 Mg 能有效地去除基 板表面的氧化膜,从而促进铝合金与基板反应促进润 湿,而在铝合金中添加少量的 Si 后,铝合金往往体现 出较好的流动性,从而促进铝合金在基板表面铺展^[7]。 近年来,熔融金属在钛化物(例如,Ti-N/Ti-C^[8]和 Ti-Ni^[9])表面的润湿性被广泛研究,但对纯钛及其合金表 面的润湿性则研究较少,相关文献报道也较少。Kondoh 等^[10]报道了 Mg 熔体在纯钛表面的润湿性,发现 Mg 能够还原基板表面 Ti-O 氧化膜,从而有效改善润 湿性;Liu 等^[11]报道了玻璃合金熔体($Ti_{32,8}$ Zr_{30,2}Ni_{5,3} $Cu_9 Be_{22,7}$)在 TC4 钛合金表面的润湿行为及界面特 征,发现随温度的升高,润湿性的改善与熔融金属的黏 度、表面张力的减小及界面反应的增强相关;Liu 等^[12] 发现3种钎料金属(Braze 580, BAg-8 和 Ticusil 合金) 只在 840 $^{\circ}$ 以上才能有效润湿 TC4 钛合金。综上,润 湿性总与温度及界面反应相关,且导致润湿机制仍不 明朗。

6061 和 4043 铝合金既是常用的热浸铝材料也是 焊接中常用的铝焊丝,6061 铝合金中微量的 Mg 能够 促进熔体润湿基板,同时表现为表面活性;4043 铝合 金中的 Si 表现为界面活性,能够促进熔体流动,也能 够促进界面反应发生。本工作选取商用 6061 和 4043 铝合金来研究其在纯钛(TA2)表面的润湿行为与界面 结构,探讨界面反应产物与润湿性及铺展动力学间的 相互联系。研究内容有望进一步丰富 TA2 热浸铝工 艺的相关基础理论。

1 实验材料与方法

实验所用的铝合金由 6061 和 4043 铝合金真空熔 炼而成, TA2 基板尺寸为 20mm×20mm×1mm, 相应 的化学成分如表 1 所示。润湿实验之前,将铝合金切 块经机械打磨去除表面氧化膜; TA2 基板抛光至表面 平均粗糙度 R_a 约 30nm(测量范围 2mm 以上), 由 DEKTAK 6M 台阶仪以 100μ m/s 速率扫描测量而 得。待熔 6061 和 4043 铝合金及 TA2 基板放入丙酮 中超声清洗 3 次,每次 3min, 然后再将样品置于真空 腔体内。

表1 实验材料的名义化学成分(质量分数/%)

Table 1	Nominal	chemical	compositions	of	experimental	materials	(mass	fraction/	′%)
---------	---------	----------	--------------	----	--------------	-----------	-------	-----------	----	---

Material	С	V	Fe	Si	Mg	Zn	Ti	Al
4043 Al alloy			0.80	5.00	0.05		0.20	Bal
6061 Al alloy			0.70	0.60	0.90	0.25	0.15	Bal
TA2	0.1		0.3	0.15			Bal	

润湿实验采用改良座滴法,在10⁻⁴Pa高真空环境 下进行,实验装置如图1所示。分别在600,650, 700℃温度下进行实验,当实验温度、真空度稳定后,由 外部磁力推进杆将待熔铝合金推至氧化铝(Al₂O₃)滴 落管开口处,并使其落至基板表面。待铝合金完全熔 化(即 t=0s,t 为等温润湿的时间),用尼康高分辨相 机记录整个润湿铺展过程,所获得图像利用数据分析 终端计算接触角和接触半径。



Fig. 1 Schematic diagram of the wetling experimental apparatus

润湿实验后,选取典型的实验样品取横截面抛光, 并将润湿后试样用 1mol/L NaOH 水溶液腐蚀去除固 体 A1,用带有牛津能谱仪(EDS)的 FEG 450 扫描电子 显微镜(SEM) 对界面、三相线微观结构及化学组分进 行分析,用 D8 Advance X 射线衍射仪(XRD)对前驱 膜、腐蚀后试样反应层中的物相进行了分析。

2 结果与分析

2.1 实验结果

熔融 6061 和 4043 铝合金在 600~700℃分别与 TA2 润湿过程中接触角及归一化接触半径随时间的 变化,如图 2 所示,其中箭头指向为曲线 Y 轴。由图 可见,600℃时 4043 铝合金不润湿 TA2,其余各温度 下 6061/4043 铝合金与 TA2 均体现出良好的最终润 湿性,随着温度升高润湿性逐渐改善,可见润湿性与温 度相关,6061 铝合金润湿性明显好于 4043 铝合金, 700℃时 6061 铝合金在 TA2 表面达到完全润湿,接触角接近 0°,如图 2(a)所示。归一化接触半径随时间呈单调变化,6061 铝合金铺展存在两个阶段,即接触半径随时间先呈指数增加之后呈线性增加,而4043 铝合金以指数增加为主,如图 2(b)所示。其中指数铺展阶段可由下式拟合而得^[13]:

 $R_{\rm d}/R_{\rm 0} = R_{\rm f}/R_{\rm 0} - a \exp[-(t/\tau)^{m}]$ (1) 式中, $R_{\rm d}$, $R_{\rm f}$ 和 $R_{\rm 0}$ 分别代表接触半径的瞬时值、最终 值和初始值;a, τ 和m为拟合参数;t为熔体在基板表 面等温润湿的时间;线性铺展阶段满足 $R^{n} = Kt$,其中 n = 1, K为拟合参数,700°C时 6061 铝合金熔体在 TA2表面出现两次线性铺展,如图 2(b)所示。铺展后 期均出现了前驱膜。



图 2 熔融 6061 和 4043 铝合金分别在 TA2 基板上 (a) 接触角随时间变化;(b) 归一化接触半径随时间的变化

Fig. 2 Molten 6061 and 4043 Al alloys on the surface of TA2 substrate

(a)variation of contact angles with time; (b)variation of normalized contact radius with time

600℃时,6061 铝合金与 TA2 润湿后典型的微观 结构,如图 3 所示。宏观上形成的前驱膜,实际上为延 伸到三相线外的界面反应层,前驱膜呈现两种形貌,底 层为Al₃Ti金属间化合物(在纵截面呈现松散的块



图 3 6061 铝合金与 TA2 在 600℃ 润湿后的 SEM 像

(a)三相线附近界面;(b)三相线附近俯视图;(c)对应于图 3(b)中的局部放大;(d)界面微观结构

Fig. 3 SEM images for 6061 Al alloy/TA2 system after isothermal wetting at 600°C

(a)cross-sectional view close to triple line zone; (b)top-view at the close of triple line; (c) high magnification image of rectangular zone in fig. 3(b); (d) the interfacial microstructure

状);上层为残余液相 Al,如图 3(a)所示。究其原因在 于,反应产生疏松的 Al-Ti 金属间化合物,能够有效地 破除 Ti 板表面的氧化膜,上层液相 Al 沿开裂的氧化 膜渗入到新鲜的 Ti 板表面继续参与反应,进而促进前 驱膜产生,前驱膜产生后进一步阻碍液-固界面物质交 流,使得铝合金熔体沿反应层铺展。因此,前驱膜呈现 上述两种形貌,且前驱膜底层优先向四周延伸,如图 3(b),(c)所示。形成的界面微观结构如图 3(d)所示,界 面反应层较为疏松,反应层上方存在结构分散的粒状金 属间化合物,元素线分布曲线分析结果表明反应层中存 在 Si 的富集,同时在反应层及铝合金熔体内均未检测到 M_g 的存在,表明在该温度下, M_g 以蒸汽的形式挥发。

600℃时,4043 铝合金与 TA2 润湿后的界面微观 结构,如图 4 所示。在这一温度下,4043 铝合金未能 润湿 TA2。在三相线附近的微观结构如图 4(a)所示, 三相线附近原部为致密层,上层为棒状相;在中心界面:在三 相线附近底部为致密层,上层为棒状相;在中心界面上 底部为夹杂棒状相的致密层,上层为疏松的块状(颗粒 状)相,表明中心界面处产生的棒状相发生分解,同时 形成连续的致密层。元素线分布曲线同样表明界面上 存在明显的 Si 富集,且致密层及棒状相中的 Si 含量 远高于颗粒状相。



图 4 4043 铝合金与 TA2 在 600℃润湿后的 SEM 像 (a)三相线附近;(b)界面中心位置

Fig. 4 SEM images for 4043 Al alloy/TA2 system after wetting at 600°C (a)at the close of triple line; (b)central position of interface

650℃时,4043 铝合金与 TA2 表现出较好的润湿 性,并出现了明显的前驱膜,三相线附近 Ti 侧残留未 分解的致密层,如图 5 所示。形成的前驱膜同样为界 面反应层在三相线外部的延伸,前驱膜结构较为疏松, 如图 5(a)所示。前驱膜同样呈现两种形貌,但与 6061 铝合金产生的前驱膜形貌有所差异,底层为疏松的 Al_aTi 金属间化合物;上层为夹杂粒状相及少量棒状 相的残余液相 Al,如图 5(b)和(c)所示。界面上形成 的反应层结构较为致密,未出现图 4 所述夹杂棒状相 的致密层,而在三相线附近底层仍存在夹杂棒状相的 致密层,表明随着温度升高界面中心处底层致密层发 生分解,同时,三相线附近反应层结构较为疏松,少量



(a)cross-sectional view close to triple line;(b) top-view at the close of triple line;(c)high magnification image of rectangle zone in fig. 5(b);(d)the interfacial microstructure;(e)the microstructure of triple line

的棒状相及粒状相分布在反应层的上方,元素线分布 曲线同样表明反应层中存在 Si 的富集,如图 5(d),(e) 所示。

为了分析润湿机理,将上述试样经 1mol/L NaOH 水溶液腐蚀将 Al 去除后的宏观形貌如图 6 (a),(d)所示。6061 铝合金试样界面中心处为致密的 颗粒状相,三相线附近为疏松的颗粒状相;4043 铝合 金试样界面中心处为疏松的颗粒状相,在三相线附近 存在金属间化合物分层现象,前驱膜上颗粒度明显小 于液滴内部,且有少量的棒状相。相应位置的微观结 构如图 6(b),(c),(e),(f)所示。4043 铝合金试样颗 粒状相对应于液/固界面上连续的界面反应层,在三相 线附近的液滴内部为分散的颗粒状相,其底部则为致 密的层片状相及少量的棒状相,如图 5(e)和图 6(f)所 示。可见,润湿过程中三相线的移动与致密的层片状 相的分解密切相关。图 7 中(a),(b)为 6061 铝合金润 湿 TA2 后形成的前驱膜及 650℃润湿后将凝固 Al 腐 蚀去除后界面的 XRD 谱。表明前驱膜主要成分为 Al₃Ti,界面产物为 Al₃Ti(对应图 3(d)中的粒状相及 连续反应层)。图 7(c),(d)分别为 4043 铝合金润湿 TA2 后形成的前驱膜及 650℃润湿后将凝固 Al 腐蚀 去除后界面的 XRD 谱。表明前驱膜主要成分为 Al₃Ti(对应于前驱膜中的颗粒状相),界面产物除 Al₃Ti(对应于前驱膜中的颗粒状相),界面产物除 Al₃Ti 外还存在部分 Ti₇Al₅Si₁₂。在微观上 Ti₇Al₅Si₁₂ 对应于图 4(a)中界面上的棒状相、连续致密层和图 6(f)中少量的棒状相。



图 6 铝合金与 TA2 润湿后样品由 NaOH 溶液去除凝固的 Al 后的宏观形貌及 SEM 像 (a)6061 铝合金/TA2 试样宏观形貌;(b),(c)对应于图 6(a)中相应位置的微观结构;(d)4043 铝合金/TA2 试样宏观形貌; (e),(f)对应于图 6(d)中相应位置的微观结构

Fig. 6 Macro-morphologies and SEM images for Al alloy/TA2 samples after Al was removed by NaOH aqueous solution (a)macro-morphology for 6061 Al alloy/TA2 sample; (b) and (c), the corresponding details in fig. 6(a);
(d)macro-morphology for 4043 Al alloy/TA2 sample; (e) and (f), the corresponding details in fig. 6(d)

2.2 分析讨论

前驱膜的宽度与温度存在典型的相互依赖关系, 且前驱膜产生的同时伴随着较好的润湿性^[7],6061 和 4043 铝合金润湿 TA2 过程中产生了明显的前驱膜, 且随着温度升高前驱膜宽度越宽,最终润湿性越好。 Lin 等^[7]曾报道,4043 和 6061 铝合金润湿低碳钢时出 现了前驱膜,同时铝合金中 Mg 的挥发作用能够促进 前驱膜产生,前驱膜形成机制与本体系类似;庄等^[14] 曾报道,Au-18Ni 和 Ag-38Cu-15Mn 钎料润湿不锈钢 时出现了前驱膜,形成机制同样与本研究体系类似。 结合图 3 和图 5 分析可知,前驱膜的产生与铝合金中 的特定组元有关,6061 铝合金为 Al-Mg 合金,但图 3(d)界面及铝合金熔体中均未检测到 Mg 的存在,表 明 6061 铝合金中微量的 Mg 以蒸汽的形式挥发后,包 裹在三相线附近充当还原剂(气相钎剂,促进还原反应 发生),来还原钛表面的氧化膜,使得氧化膜开裂,铝液 沿开裂的氧化膜渗入新鲜的 Ti 板表面参与反应,并产 生疏松的 Al_aTi 金属间化合物,同时疏松相能够继续 破除 Ti 板表面的氧化膜,促进三相线区域界面反应发 生,进而促进前驱膜的产生。随着实验温度升高,Al 熔体周围包裹的 Al 蒸汽同样可以成为还原剂来诱发 前驱膜产生,前驱膜实质上是超出三相线的反应产物 层,其形成机制为"皮下渗透"机制。

据文献[15]报道, $Ti_7 Al_5 Si_{12}(\tau_1)$ 在 579°C 将会发 生如下分解:

$$L + \tau_1 \leftrightarrow [Si]_{Al} + Al \tag{2}$$

式中:L 为液相; τ_1 为 Ti₇Al₅Si₁₂相;[Si]_{Al}表示 Si 溶解 到 Al 液中。同时,由于界面上存在 Si 的富集,导致分



(a)XRD patterns of the phases at the precursor films for 6061 Al/ TA2 samples after isothermal wetting at 700°C; (b)XRD patterns of the phases for the exposed interface of 6061 Al/TA2 after isothermal wetting at 650°C through removing of the solidified Al;
(c)XRD patterns of the phases at the precursor films for 4043 Al/ TA2 samples after isothermal wetting at 700°C; (d)XRD patterns of the phases for the exposed interface of 4043 Al/TA2 after isothermal wetting at 650°C through removing of the solidified Al;
(e) the original surface of TA2

图 7 不同状态下的 XRD 谱

Fig. 7 XRD patterns in different status

解反应(2)推迟进行。事实上,这种界面上 Si 元素的 富集满足热力学形成条件。在 Al-Si/Ti 体系中,Si 在 界面上的富集可以用吸附能来表征^[16],吸附能越负越 倾向于在界面富集,表达式为:

$$E_{M(B)}^{\infty SL} = m_1 (\lambda_{AM} - \lambda_{BM} - \lambda_{AB})$$
 (3)
式中: m_1 为界面结构系数(恒正值); λ_{ij} 为两种元素的
相互作用系数,其中下标 A,B 和 M 分别代表基板金
属,溶剂金属和溶质金属。 λ_{ij} 可以由混合焓定性计算
得到:

$$\lambda_{ii} = (\overline{\Delta H}_{i(i)}^{\infty} + \overline{\Delta H}_{i(i)}^{\infty})/2 \tag{4}$$

式中, $\overline{\Delta H_{i(j)}^{\infty}}$ 代表溶质与溶剂的相互混合焓,其值可 基于 Miedema 模型估算^[17]。计算 Al-Si/Ti 体系所得 的 $E_{M(B)}^{\infty SL}/m_1$ 为一73.4kJ/mol,相比 Al-Mg/Ti 体系计 算所得的吸附能为 221.4kJ/mol。计算结果表明 Si 更容易在界面富集。

该反应润湿体系中,界面反应产生金属间化合物 影响最终润湿性。Voytovych等^[18]认为在 AgCuTi/ Al₂O₃体系的反应润湿中,界面产生显金属性的化合 物后,熔体在反应层表面铺展而非在 Al₂O₃ 表面铺 展,进而促进熔体润湿母材,Lin等^[19]和 Xian^[20]认为 在金属/陶瓷润湿体系中,前驱膜产生后熔体在显金属 性的前驱膜表面铺展,进而有效促进熔体润湿母材。 上述表明,对于金属/陶瓷体系,界面产生显金属性化 合物或显金属性前驱膜后,能够替代原来的氧化物基 板,促进熔体润湿母材。而对于金属/金属体系而言, 界面反应产生金属间化合物对润湿性的影响更为复 杂,Protsenko 等^[21]认为在金属/金属的反应润湿体系 中,金属间化合物的作用在于清除母材表面的氧化膜, 进而裸露新鲜(金属性)表面而后促进润湿;Delannay 等^[22]认为熔融金属在金属基板表面的润湿中,基板表 面存在氧化膜会抑制熔体润湿母材,液态金属还原基 板表面氧化膜同时在界面产生金属间化合物能够促进 熔体润湿母材;Li 等^[23]认为在 AgCuTi/TiAl 体系的 反应润湿中,反应产生金属间化合物能够破除基板表 面氧化膜,促进润湿;Yin 等^[24]认为在金属/金属的反 应润湿体系中,反应产生疏松的金属间化合物能够促 进润湿,而产生致密的金属间化合物则抑制润湿。综 上,对于金属/陶瓷体系而言,界面产生显金属性的化 合物能够替代氧化物陶瓷基板,促进润湿;对于金属/ 金属体系而言,界面产生金属间化合物能够破除基板 表面氧化膜,促进界面反应发生,促进润湿。

在本体系中,润湿模型如图8所示。600℃时, 4043 铝合金不润湿 TA2,但界面明显发生反应并产生 金属间化合物,表明不是界面发生反应就能够促进润 湿。究其原因在于,Si在界面大量富集后产生 Ti₇ Al₅ Si₁₂ 相,理论上当温度达到 579℃时 Ti₇ Al₅ Si₁₂ 相开始分解,而本体系中 Si 在界面大量的富集作用导 致分解反应推迟进行,600℃界面底层产生致密的 Ti7 Al5 Si12,阻碍三相线处固-液界面物质交流,进而阻 碍熔体润湿母材,润湿过程与图 8(a)相对应。随着温 度升高,片层状及棒状 Ti₇ Al₅ Si₁₂ 相开始分解,同时三 相线附近产生疏松的颗粒状 $Al_a Ti H($ 如图 6 所示), 疏松的颗粒状相产生后可以破除 Ti 表面的氧化膜,促 进三相线处物质交流,进而促进润湿,润湿过程与图 8(b)相对应。6061 铝合金试样润湿性明显好于 4043 铝合金试样,其原因在于,6061 铝合金中 Si 含量很 低,三相线处生成疏松的颗粒状 Ala Ti 可以破除 Ti 表 面的氧化膜,在 6061 铝合金熔体中未检测到 Mg 的存 在,表明 Mg 有可能以蒸汽的形式挥发,挥发的 Mg 蒸 汽包裹在三相线附近能够还原 Ti 表面的氧化膜,进而 促进铝合金熔体润湿 Ti 板,润湿过程与图 8(c),(d) 相对应。因此,6061铝合金试样润湿性明显好于 4043铝合金试样。综上,界面产生致密相后会抑制固-液界 面物质交流进而抑制润湿;界面产生疏松的金属间化 合物能够破除基板表面氧化膜,促进三相线区域固-液 界面物质交流,从而促进润湿。

Al/Ti属于典型的反应润湿,图 2(b)中归一化接触半径与时间的关系可以得出其铺展分为两种典型的 类型,即非线性铺展与线性铺展。两种铺展类型可以 由 Dezellus 等^[25]提出的反应润湿模型来描述。对于 非线性铺展,可以由下式拟合图 2(a)中的数据得到动



图 8 4043 铝合金/TA2 (a),(b)及 6061 铝合金/TA2 (c),(d)润湿模型 Fig. 8 Wetting models for 4043 Al alloy/TA2 (a),(b) and 6061 Al alloy/TA2 (c),(d)

力学常数 k1:

 $\cos\theta_{e} - \cos\theta = (\cos\theta_{e} - \cos\theta_{0})\exp(-k_{1}t)$ (5) 式中, θ_{e} , θ 和 θ_{0} 分别代表平衡接触角、瞬时接触角和 初始接触角。对于线性铺展,铺展动力学常数 k_{2} 即为 线性铺展阶段的斜率,表达式为^[16]:

 $\mathrm{d}R_{\mathrm{d}}/\mathrm{d}t = k_2 = C \exp(-\Delta E_{\mathrm{a}}/RT)$ (6)式中:C为常数; R_{d} 为瞬时接触半径; ΔE_{a} 为激活能;R为气体常数;T为温度。拟合得到的动力学常数 k1 和 k_2 的 Arrhenius 曲线如图 9 所示,根据斜率可计算得 到反应润湿的激活能。对于 6061 铝合金/TA2,非线 性阶段和线性阶段的润湿激活能分别为 5kJ/mol 和 112kJ/mol。对于 4043 铝合金/TA2 非线性阶段的润 湿激活能为 47kJ/mol。实际上,润湿激活能对应于界 面反应的不同阶段。在实验温度范围,单位摩尔反应 物生成 $Ti_7 Al_5 Si_{12}$ 和 $Al_3 Ti$ 的 Gibbs 自由能分别为 4kJ/mol和 $30kJ/mol^{[26]}$,而铝合金熔体对应非线性阶 段的润湿激活能在 $47 \sim 56 \text{ kJ/mol}$ 范围内。因此,可以 得出非线性铺展阶段与界面上 Ti₇Al₅Si₁₂的分解引起 的界面能变化相关,图 5(e)中三相线区域未完全分解 的 Ti₇ Al₅ Si₁₂ 印证了上述非线性阶段由 Ti₇ Al₅ Si₁₂ 的 分解主导铺展过程。





3 结论

(1)Al/Ti 体系属于典型的反应润湿,界面致密的 片层状 Ti₇Al₅Si₁₂相产生后阻碍三相线附近固-液界面 物质交流,进而抑制润湿,片层状相的分解及疏松的颗 粒状 Al₃ Ti 相产生后能够去除 Ti 板表面的氧化膜,使 得铝合金容易接触到金属性的 Ti 基板并参与反应,进 而促进润湿。

(2)整个润湿过程分为两个阶段:指数铺展及线性 铺展阶段, $Ti_7Al_5Si_{12}$ 的分解对应于指数铺展阶段, 6061 铝合金在两个阶段的活化能分别为 56kJ/mol 和 112kJ/mol,4043 铝合金对应指数铺展阶段的活化能 为 $47kJ/mol_{\circ}$

(3)整个润湿过程中出现了明显的前驱膜,且前驱 膜的宽度与温度存在典型的相互依赖关系,同时前驱 膜越宽最终润湿性越好,其形成机制为"皮下渗透" 机制。

参考文献

- BOYER R R. An overview on the use of titanium in the aerospace industry [J]. Materials Science and Engineering: A, 1996, 213 (1): 103-114.
- [2] LEYENS C, PETERS M, KAYSSER W A. Intermetallic Ti-Al coatings for protection of titanium alloys: oxidation and mechanical behavior [J]. Surface and Coatings Technology, 1997, 94/ 95: 34-40.
- EGGELER G, AUER W, KAESCHE H. On the influence of silicon on the growth of the alloy layer during hot dip aluminizing
 [J]. Journal of Materials Science, 1986, 21(9): 3348-3350.
- [4] DEQING W, ZIYUAN S, YINGLI T. Microstructure and oxidation of hot-dip aluminized titanium at high temperature [J]. Applied Surface Science, 2005, 250(1): 238-246.
- [5] ZHANG Z G, PENG Y P, MAO Y L, et al. Effect of hot-dip aluminizing on the oxidation resistance of Ti-6Al-4V alloy at high temperatures [J]. Corrosion Science, 2012, 55: 187-193.
- [6] SWAMINATHAN S, KOLL T, POHL M, et al. Hot Dip Galvanizing Simulation of Interstitial Free Steel by Liquid Zinc Spin Coater: Influence of Dew Point on Surface Chemistry and Wettability [J]. Steel Research International, 2008, 79(1): 66-72.
- [7] LIN Q, JIN P, CAO R, et al. Reactive wetting of low carbon steel by Al 4043 and 6061 alloys at 600-750°C [J]. Surface and Coatings Technology, 2016, 302: 166-172.
- [8] XIAO P, DERBY B. Wetting of titanium nitride and titanium carbide by liquid metals [J]. Acta Materialia, 1996, 44(1): 307-14.

- [9] KIM P, JANG J, LEE T, et al. Interfacial reaction and wetting behavior in eutectic SnPb solder on Ni/Ti thin films and Ni foils
 [J]. Journal of Applied Physics, 1999, 86(12): 6746-6751.
- [10] KONDOH K, KAWAKAMI M, IMAI H, et al. Wettability of pure Ti by molten pure Mg droplets [J]. Acta Materialia, 2010, 58(2): 606-614.
- [11] LIU D M, ZHU Z W, LI Z K, et al. Wetting behavior and interface characteristic of Ti32. 8Zr30. 2Ni5. 3Cu9Be22. 7/ Ti6Al4V[C]//Proceedings of the Materials Science Forum, Churerstrasse, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016: 385-390.
- [12] LIUCC, OUCL, SHIUERK. The microstructural observation and wettability study of brazing Ti-6Al-4V and 304 stainless steel using three braze alloys [J]. Journal of Materials Science, 2002, 37(11): 2225-2235.
- GREMILLARD L, SAIZ E, RADMILOVIC V R, et al. Role of titanium on the reactive spreading of lead-free solders on alumina
 [J]. Journal of Materials Research, 2006, 21(12): 3222-3233.
- [14] 庄鸿寿,罗格夏特 E. 高温钎焊[M]. 北京:国防工业出版社, 1989.
- [15] EFFENBERG G, ILYENKO S. Selected systems from Al-Si to Ni-Si-Ti[M]. Heidelberg: Spinger-Verlag Berlin, 2006.
- [16] EUSTATHOPOULOS N, COUDURIER L. Adsorption and wettability in metal/ceramic systems [J]. Lecture Notes in Physics, 1991, 386:15-23.
- [17] ZHANG R F, SHENG S H, LIU B X. Predicting the formation enthalpies of binary intermetallic compounds [J]. Chemical Physics Letters, 2007, 442(4/6): 511-514.
- [18] VOYTOVYCH R, ROBAUT F, EUSTATHOPOULOS N. The relation between wetting and interfacial chemistry in the CuAgTi/alumina system [J]. Acta Materialia, 2006, 54(8): 2205-2214.

- [19] LIN Q, QIU F, SUI R. Characteristics of precursor film in the wetting of Zr-based alloys on ZrC substrate at 1253K [J]. Thin Solid Films, 2014, 558: 231-236.
- [20] XIAN A P. Precursor film of tin-based active solder wetting on ceramics [J]. Journal of Materials Science, 1993, 28 (4): 1019-1030.
- [21] PROTSENKO P, TERLAIN A, TRASKINE V, et al. The role of intermetallics in wetting in metallic systems [J]. Scripta Materialia, 2001, 45(12): 1439-1445.
- [22] DELANNAY F, FROYEN L, DERUYTTERE A. The wetting of solids by molten metals and its relation to the preparation of metal-matrix composites composites [J]. Journal of Materials Science, 1987, 22(1): 1-16.
- [23] LI Y, LIU W, SEKULIC DP, et al. Reactive wetting of AgCu-Ti filler metal on the TiAl-based alloy substrate [J]. Applied Surface Science, 2012, 259: 343-348.
- [24] YIN L, MESCHTER S J, SINGLER T J. Wetting in the Au-Sn system [J]. Acta Materialia, 2004, 52(10): 2873-2888.
- [25] DEZELLUS O, HODAJ F, EUSTATHOPOULOS N. Progress in modelling of chemical-reaction limited wetting [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2003, 23(15): 2797-2803.
- [26] BARIN I, PLATZKI G. Thermochemical data of pure substances [M]. 3rd ed. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 1995.

基金项目:国家自然科学基金项目(51665031,51465032)

收稿日期:2017-06-06;修订日期:2017-09-14

通讯作者:林巧力(1983一),男,副教授,博士,主要从事表面改性、金属/金属及金属/陶瓷体系润湿性研究,联系地址:甘肃省兰州市兰州理 工大学本部(730050),E-mail:lqllingiaoli@163.com

(本文责编:齐书涵)